

HX BOND+

Self-Etch Bonding Agent

HX. Bond+ adalah Self-Etch bonding agent yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan perekatan yang kuat, tahan lama, serta efisien dalam penggunaan, mengandung Monomer MDP dan 4-Meta, dan Resin berbasis BisGMA untuk perekatan yang lebih fleksibel dan tahan kondisi lembab. HX.Bond+ menggunakan Ethanol dan Air sebagai Solvent, serta mengandung partikel filler nano (20nm) dengan distribusi yang sangat padat dan mengandung silane coupling agent untuk menghasilkan sifat mekanis yang tinggi (ISO 29022:2013). Dengan PH <4 (Mild Etching).

-  **Universal**
(Self Etch, Selective Etch, Total Etch)
-  **Shear Bond Strength**
>25 Mpa
-  **PH ≤ 4 (Mild Etching)**
-  **Low Viscosity**



MUDAH DIBUKA, CUKUP SATU KALI KLIK

Desain penutup yang inovatif ini memungkinkan pembukaan sekali klik yang sangat mudah. Tidak ada lagi memutar atau menarik. Cukup satu sentuhan ringan yang meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kontaminasi silang.



DIAMETER LUBANG PRESISI, HEMAT SETIAP TETES

Diameter yang dioptimalkan ini memastikan pengeluaran yang terkontrol dan tepat, memungkinkan Anda mengaplikasikan jumlah bonding yang ideal setiap saat. Kami merancang diameter lubang botol HX Bond+ dengan presisi. Tidak terlalu besar sehingga cairan keluar berlebihan, dan tidak terlalu kecil yang membuat sulit untuk mengeluarkannya.

Indikasi:

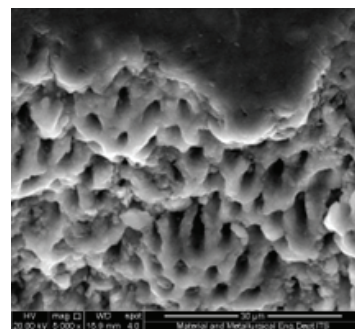
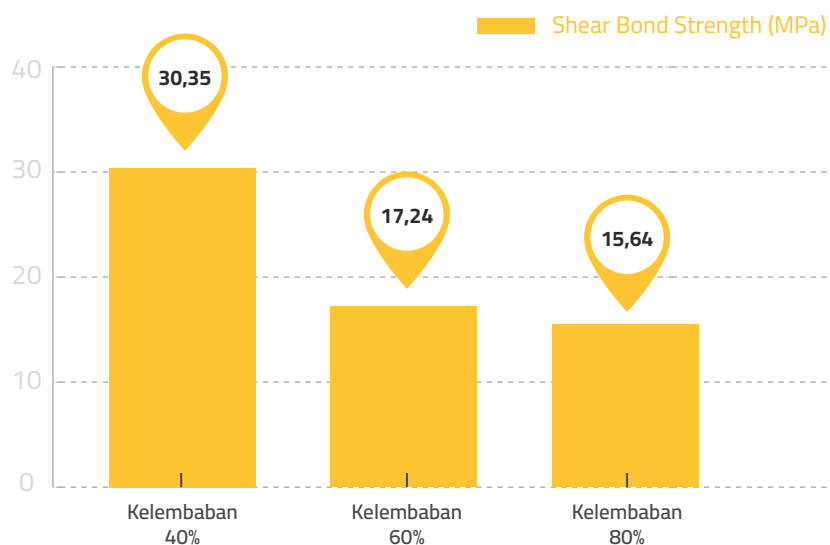
- Bonding Agent untuk Light Cure Restorasi Resin Komposit.
- Porcelain, Zirconia, dan Metal.
- Bonding aplikasi material Self & Dual Cure core build-up.
- Repair untuk Komposit dan Compomer.

Cara Pakai:

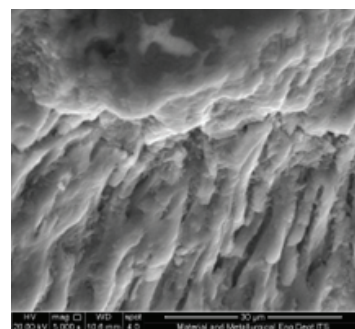
-  Bersihkan area yang akan diaplikasikan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan angin.
-  Aplikasikan HX.Bond+ pada area yang ingin diaplikasikan, diamkan selama 5 detik untuk mendapatkan self-etch.
-  Kemudian keringkan dengan angin untuk proses evaporasi solvent, akan terlihat lapisan mengkilat (Glossy) dan tidak bergerak.
-  Light curing selama 10 detik.

Shear Bond Strength

Berdasarkan hasil uji laboratorium, pada kelembaban ideal 40% nilai rata-rata Shear Bond Strength mencapai **30,35 MPa**. Ini menunjukkan HX Bond+ kekuatan retensi yang maksimal saat diaplikasikan dalam kondisi terkontrol.



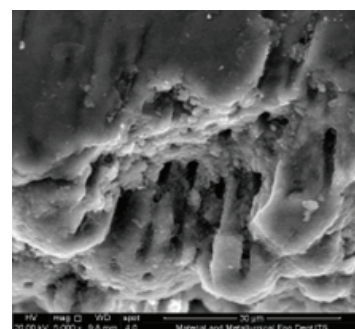
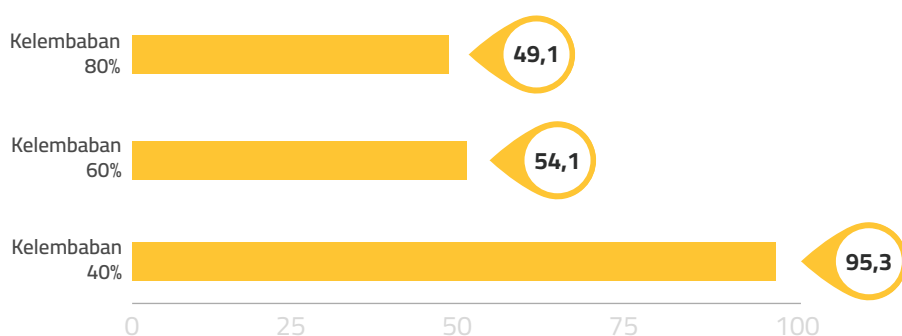
Hasil Uji SEM kelembaban 40%



Hasil Uji SEM kelembaban 60%

Tensile Bond Strength

Kemampuan menahan gaya tarik hingga **95.3 MPa**, resin ini dirancang untuk **tidak mudah retak atau putus di bawah tekanan ekstrem**.



Hasil Uji SEM kelembaban 80%

Kasus Klinis

Kasus **Caries Class IV** oleh drg. **Mirza V Shan** dengan kombinasi HX Bond+ dan Replix Nano-Hybrid Komposit membuktikan kombinasi keduanya mampu mengubah kasus black triangles dan keausan gigi menjadi senyum yang **padat, estetik, dan alami**. HX Bond+ mampu menciptakan infiltrasi sempurna, membentuk resin tags yang padat dan mengunci kuat ke dalam tubulus.



Foto klinis atas izin drg. Mirza V Shan